**様式第一**

年　　月　　日

　　経済産業大臣　名　　殿

住　　　　　所

名　　　　　称

代表者の氏名

情報処理の促進に関する法律第64条第１項の規定に基づき、下記の実施計画を作成し、提出します。

実施計画

１．名称等

事業者の氏名又は名称

代表者名（事業者が法人の場合）

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

法人番号

日本標準産業分類における該当中分類名称及びその番号

担当者連絡先（所属、氏名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等）

２．公募対象半導体の生産の目標及び実施体制

1. 公募対象半導体の生産の目標

（イ）公募対象半導体に関する内容

|  |  |
| --- | --- |
| 公募対象半導体 | 確認（注１） |
| 演算を行う半導体であって、面積が0.0187平方マイクロメートル以下の電子回路（6個のＧＡＡ構造のトランジスターで構成されるものに限る。）をその内部に含むもの | □ |

（注１）記載された性能を満たす製品を生産する予定である場合は、□にレ印を付けること。

（ロ）公募対象半導体の生産の開始の時期

|  |
| --- |
|  |

（注２）単なる試作に留まらず、顧客との継続的な取引を念頭に置いた商業生産を開始する時期を記載すること。

（２）公募対象半導体の生産の実施体制

（イ）経営体制及び企業統治体制に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注３）資本関係についても記載すること。

（注４）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）モニタリングの仕組み等に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

　（ハ）技術管理体制に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注６）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ニ）コア技術等に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注７）公募対象半導体の生産に有用かつ中核的な技術（公然と知られていないものに限る。）を「コア技術」と定義し、コア技術及びコア技術の実現に直接寄与する公然と知られていない技術を「コア技術等」と定義する。

（注８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

３．公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎

（１）前工程について

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 具体的な内容について |
| 生産技術・生産工程の開発状況 |  |
| 生産設備（搬送装置等）の開発状況 |  |
| ＥＵＶ露光技術の開発状況 |  |
| パイロットラインの構築状況 |  |
| テストチップの試作状況 |  |
| 歩留まりに係る状況 |  |
| ＰＤＫ・ＩＰの開発状況 |  |
| その他 |  |

（注９）必要に応じて各項目の記載内容を証明又は補足する書類を提出すること。

（２）後工程について

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 具体的な内容について |
| パッケージ生産技術・生産工程の開発 |  |
| パッケージ設計技術の開発 |  |
| 良品チップ選別技術開発 |  |
| パイロットラインの構築状況 |  |
| その他 |  |

（注１０）必要に応じて各項目の記載内容を証明又は補足する書類を提出すること。

４．特定取組の内容及び実施期間

（１）特定取組の内容

1. 技術開発に係る計画・体制に関する事項

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 具体的な内容について |
| 生産技術・生産工程の開発状況 |  |
| 生産設備（搬送装置等）の開発状況 |  |
| ＥＵＶ露光技術の開発状況 |  |
| パイロットラインの構築状況 |  |
| テストチップの試作状況 |  |
| 歩留まりに係る状況 |  |
| ＰＤＫ・ＩＰの開発状況 |  |
| パッケージ生産技術・生産工程の開発 |  |
| パッケージ設計技術の開発 |  |
| 良品チップ選別技術開発 |  |
| パイロットラインの構築状況 |  |
| その他 |  |

（注１１）技術開発に係る計画を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載すること。

（注１２）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）公募対象半導体の生産に係る事業戦略に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注１３）獲得を見込む市場の成長性や需給見通し等を踏まえた市場獲得の可能性についても記載すること

（注１４）競合他社との比較を踏まえた顧客獲得の戦略についても記載すること。

（注１５）顧客の獲得の見込みについても記載すること。

（注１６）他企業・他機関との連携や知的財産の利活用についても記載すること。
（注１７）公募対象半導体の生産に係る事業戦略を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載す

ること。

（注１８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ハ）生産設備の整備に係る計画に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注１９）各年度における想定する生産能力の規模についても記載をすること。
（注２０）生産設備の整備に係る計画を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載すること。

（注２１）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ニ）生産設備及び原材料等の安定的な調達に係る取組に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注２２）関連事業者とのコミュニケーション状況、輸送経路及び輸送体制等についても記載すること。

（注２３）工業用水等の確保に係る取組についても記載すること。

（注２４）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ホ）技術者等の人材確保・育成に係る取組に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注２５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（注２６）半導体に係る人材育成に取り組む産学連携組織の加入、当該組織への参加状況についても記載すること。加えて、関係する教育機関、研究機関又は技術研究組合等と連携状況についても記載すること。

（ヘ）その他特定取組の内容に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注２７）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（２）特定取組の実施期間

|  |
| --- |
|  |

（注２８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（３）公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国・地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項

（イ）公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国・地方公共団体その他の関係者との連携に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注２９）半導体に係る人材育成や研究開発及び実証に関する施策との連携体制について記載すること。

（注３０）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）公募対象半導体に係る特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注３１）雇用創出、投資誘発効果、関連産業や地域経済への経済波及等を記載すること。

（注３２）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

５．特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 民間投資家等からの出資 |  |  |  |  |  |  |  |
| 独立行政法人情報処理推進機構（以下「ＩＰＡ」という。）からの出資 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＩＰＡからの劣後融資等 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＩＰＡによる債務の保証を伴う民間金融機関等からの融資等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民間金融機関等からの融資等 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他自己資金等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |

＜備考欄＞

|  |
| --- |
|  |

（注３３）特定取組の実施期間に合わせて列を追加すること。

（注３４）民間投資家等又は民間金融機関等との資金調達に係るコミュニケーション状況等について、備考欄に記載すること。

（注３５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

６．希望する支援措置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支援措置 | 希望する | 希望しない |
| ＩＰＡによる出資 |  |  |
| ＩＰＡによる現物出資 |  |  |
| ＩＰＡによる劣後融資等 |  |  |
| ＩＰＡによる債務の保証 |  |  |
| ＩＰＡによる利子補給金の支給 |  |  |

＜備考欄＞

|  |
| --- |
|  |

（注３６）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の施設又は設備のＩＰＡによる現物出資を受けようとする場合にあっては、その旨その他当該施設又は設備に関する事項を備考欄に記載すること。

（注３７）ＩＰＡによる債務の保証を受けようとする場合にあっては、想定する保証割合を備考欄に記載すること。

（注３８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

７．財務計画に関する事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 売上高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 売上総利益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 売上総利益率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業利益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業利益率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |  |  |  |  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |  |  |  |  |
| フリー・キャッシュ・フロー |  |  |  |  |  |  |  |
| D/Eレシオ |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己資本比率 |  |  |  |  |  |  |  |

（注３９）フリー・キャッシュ・フローとは営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの。

（注４０）Ｄ/Ｅレシオとは有利子負債を自己資本で割ったもの。

（注４１）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

８．株式の内容に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４２）法第47条第１項第13号の規定による出資又は現物出資を受けようとする場合に記載すること。

（注４３）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

９．中長期的な技術開発・事業戦略・財務・ガバナンスの一体性に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４４）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

１０．特定取組に関する信頼性の確保等に関する事項

（１）過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準の順守に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（２）外国の法的環境等により特定取組の適切性への影響に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４６）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（３）事業継続計画の策定等のリスク管理に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４７）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（４）国内関係法令の遵守に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（５）サイバーセキュリティの確保に係る対策に関する事項

|  |
| --- |
|  |

（注４９）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

添付書類目次

添付書類

|  |  |
| --- | --- |
| １－(１) | 定款（これに準ずるものを含む。）の写し |
| １－(２) | 登記事項証明書（登記をしている場合） |
| ２－(１) | 事業報告の写し又はこれに準ずるもの |
| ２－(２) | 貸借対照表又はこれに準ずるもの |
| ２－(３) | 損益計算書又はこれに準ずるもの |
| ２－(４) | キャッシュ・フロー計算書又はこれに準ずるもの |
| ３－(１) | 特定取組の実施期間内における貸借対照表のシミュレーションモデル |
| ３－(２) | 特定取組の実施期間内における損益計算書のシミュレーションモデル |
| ３－(３) | 特定取組の実施期間内におけるキャッシュ・フロー計算書のシミュレーションモデル |
| ４ | 法第47条第１項第13号の規定による出資又は現物出資を受けようとする場合にあっては、発行する株式の内容に関する書類及び株式価値算出に関する書類 |
| ５ | その他実施計画の内容を補足するために必要な書類 |

（備考）

１．経済産業大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。